

证券代码：002916

证券简称：深南电路

### 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-06

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	申万宏源证券、台湾富邦证券
时间	2021年4月21日-4月23日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：谢丹。
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流主要内容：</b></p> <p><b>Q1、请简述公司一季度经营业绩情况。</b></p> <p>公司2021年一季度营业收入27.25亿元，同比增长9.10%；实现归母净利润2.44亿元，同比下降12.01%。由于春节因素和通信市场调整的双重影响，PCB业务受到一定影响，但数据中心订单增长较快；PCBA业务总体保持平稳；封装基板业务因需求旺盛、无锡工厂爬坡顺利，同比有一定增长。从利润层面看，受通信市场调整的影响，公司产能利用率较上年同期下降，单位固定成本分摊增加；产品结构调整，低毛利产品较同期增加；此外，公司在汽车、存储等方面的研发投入增加，共同影响公司一季度归母净利润变化。</p> <p><b>Q2、公司对2021年通信市场如何展望？</b></p> <p>根据工信部信息显示，我国2021年计划新建5G基站60万个，在实现地级以上城市深度覆盖的基础上，加速向有条件的县镇延伸。公司目前通信类产品以700M项目产品为主，后续若5G需求逐步释放，通信市场需求预计会有所回升，公司将对此保持密切关注。</p>

**Q3、目前公司原材料供给方面是否存在压力？**

公司作为原材料供应商战略客户，在原材料供给上能够获得一定保障。一方面，公司会通过内部精益提升等手段提高效率，节省成本；另一方面，公司会加强与供应商、客户的沟通协商，共同面对材料价格上涨压力，努力实现共赢。

**Q4、公司南通三期工厂建设进度。**

公司南通三期项目建设进展顺利，预计 2021 年 4 季度投产。

**Q5、公司对汽车电子业务的展望。**

汽车电子领域公司汽车电子业务主要聚焦 ADAS 和新能源汽车方向，主要面向 TIER1（车厂一级供应商）客户，公司也会参与整车厂部分研发项目合作。公司已积极投入汽车电子相关技术研发，积累生产能力，并与国内外部分知名厂商开展合作。未来伴随各类终端应用（车联网、物联网）的涌现，汽车也可能成为大的移动终端，公司在通信领域的技术优势可进一步延伸。

**Q6、公司封装基板业务订单能见度。**

目前封装基板市场需求旺盛，公司封装基板业务订单保持在较为饱满的水平。

**Q7、公司封装基板业务主要产品类型。**

公司生产的封装基板产品主要分为存储芯片封装基板、微机电系统封装基板、射频模块封装基板、处理器芯片封装基板和高速通信封装基板等五类。目前，应用于嵌入式存储芯片的高端存储芯片封装基板已大规模量产；在处理器芯片封装基板方面，倒装封装（FC-CSP）基板已具备量产能力。

注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单	无
日期	2021 年 5 月 6 日